

股票代碼：5425

台灣半導體股份有限公司及子公司
合併財務報告暨會計師核閱報告

民國一〇九年及一〇八年第一季

公司地址：新北市新店區北新路三段205號11樓
電話：(02)89131588

目 錄

項 目	頁 次
一、封 面	1
二、目 錄	2
三、會計師核閱報告書	3
四、合併資產負債表	4
五、合併綜合損益表	5
六、合併權益變動表	6
七、合併現金流量表	7
八、合併財務報告附註	
(一)公司沿革	8
(二)通過財務報告之日期及程序	8
(三)新發布及修訂準則及解釋之適用	8~9
(四)重大會計政策之彙總說明	9~11
(五)重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源	11
(六)重要會計項目之說明	11~38
(七)關係人交易	39
(八)質押之資產	39
(九)重大或有負債及未認列之合約承諾	39
(十)重大之災害損失	39
(十一)重大之期後事項	39
(十二)其 他	39
(十三)附註揭露事項	
1.重大交易事項相關資訊	40~42
2.轉投資事業相關資訊	42~43
3.大陸投資資訊	43~44
4.主要股東資訊	44
(十四)部門資訊	44~45



安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 11049, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667
Internet 網址 kpmg.com/tw

會計師核閱報告

台灣半導體股份有限公司董事會 公鑒：

前言

台灣半導體股份有限公司及其子公司民國一〇九年及一〇八年三月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇九年及一〇八年一月一日至三月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師核閱竣事。依證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製允當表達之合併財務報告係管理階層之責任，本會計師之責任係依據核閱結果對合併財務報告作成結論。

範圍

除保留結論之基礎段所述者外，本會計師係依照審計準則公報第六十五號「財務報表之核閱」執行核閱工作。核閱合併財務報告時所執行之程序包括查詢(主要向負責財務與會計事務之人員查詢)、分析性程序及其他核閱程序。核閱工作之範圍明顯小於查核工作之範圍，因此本會計師可能無法察覺所有可藉由查核工作辨認之重大事項，故無法表示查核意見。

保留結論之基礎

如合併財務報告附註四(二)所述，列入上開合併財務報告之部份非重要子公司，係依該等被投資公司同期間未經會計師核閱之財務報告為依據，民國一〇九年及一〇八年三月三十一日之資產總額分別為1,973,886千元及2,031,033千元，分別占合併資產總額之13.88%及13.41%；負債總額分別為180,616千元及122,812千元，分別占合併負債總額之2.75%及1.62%；民國一〇九年及一〇八年一月一日至三月三十一日之綜合損益分別為1,808千元及24,329千元，分別占合併綜合損益之1.09%及7.49%。

保留結論

依本會計師核閱結果及其他會計師之核閱報告(請參閱其他事項段)，除保留結論之基礎段所述該等被投資公司財務報告倘經會計師核閱，對合併財務報告可能有所調整之影響外，並未發現上開合併財務報告在所有重大方面有未依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製，致無法允當表達台灣半導體股份有限公司及其子公司民國一〇九年及一〇八年三月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇九年及一〇八年一月一日至三月三十一日之合併財務績效及合併現金流量之情事。

其他事項

列入上開合併財務報告之子公司中，有關鼎翰科技股份有限公司之財務報告未經本會計師核閱，而係由其他會計師核閱，因此，本會計師對上開合併財務報告之核閱結果，有關鼎翰科技股份有限公司之財務報告所列之金額係依據其他會計師之核閱報告。鼎翰科技股份有限公司於民國一〇九年及一〇八年三月三十一日之資產總額分別為6,082,060千元及6,564,897千元，分別占合併資產總額之42.78%及43.34%；於民國一〇九年及一〇八年一月一日至三月三十一日之營業收入淨額分別為1,288,801千元及1,290,942千元，分別占合併營業收入淨額之54.12%及52.15%。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

梅元貞



許育峰



證券主管機關：金管證六字第0940100754號
核准簽證文號：台財證六字第0930105495號
民國一〇九年五月十二日

民國一〇九年及一〇八年三月三十一日僅經核閱，未依一般公認審計準則查核
台灣半導體股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇九年三月三十一日、一〇八年十二月三十一日及三月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	109.3.31		108.12.31		108.3.31 (調整後)			109.3.31		108.12.31		108.3.31 (調整後)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
流動資產：							負債及權益						
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 2,122,097	15	2,230,256	16	2,634,893	17	2100 短期借款(附註六(十一))	\$ 1,452,201	10	1,762,247	12	1,298,800	9
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註六(二))	1,510	-	4,739	-	203,845	1	2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註六(二)及(十四))	4,999	-	361	-	1,679	-
1150 應收票據淨額(附註六(三))	97	-	189	-	378	-	2150 應付票據	-	-	1,781	-	-	-
1170 應收帳款淨額(附註六(三))	2,003,205	14	2,124,670	15	2,325,258	16	2170 應付帳款	1,028,404	7	1,023,129	7	1,089,137	7
1200 其他應收款	52,883	-	36,379	-	68,385	-	2200 其他應付款(附註六(十三))	656,533	5	717,820	5	806,910	5
1220 本期所得稅資產	1,586	-	1,573	-	92	-	2230 本期所得稅負債	243,233	2	193,383	2	340,664	2
130X 存貨(附註六(四))	1,801,819	13	1,761,137	12	1,836,085	12	2321 一年內到期應付公司債(附註六(十四))	890,777	6	887,388	6	877,224	6
1410 預付款項	212,178	2	210,431	2	277,658	2	2322 一年內到期長期借款(附註六(十二))	50,000	-	-	-	245,000	2
1476 其他金融資產—流動(附註六(二))	319,465	2	258,300	2	183,200	1	2280 租賃負債—流動(附註六(十五))	95,371	1	94,330	1	89,640	1
	6,514,840	46	6,627,674	47	7,529,794	49	2399 其他流動負債	139,216	1	162,769	1	158,810	1
非流動資產：								4,560,734	32	4,843,208	34	4,907,864	33
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六))	4,698,864	33	4,331,589	30	3,757,242	25	非流動負債：						
1755 使用權資產(附註六(七))	390,617	3	413,443	3	448,157	3	2540 長期借款(附註六(十二))	978,150	7	1,014,500	7	1,715,000	11
1822 無形資產(附註六(八)及(廿五))	565,573	4	555,703	4	586,970	4	2580 租賃負債—非流動(附註六(十五))	285,923	2	319,567	2	333,137	2
1805 商譽(附註六(九)及(廿五))	1,118,616	8	1,109,548	8	1,140,637	8	2640 淨確定福利負債—非流動	49,305	-	49,317	-	50,571	-
1840 遞延所得稅資產	494,652	3	492,099	3	438,613	3	2570 遞延所得稅負債	608,435	4	607,249	4	518,923	4
1980 其他金融資產—非流動(附註六(二))	67,545	-	67,244	-	67,555	-	2670 其他非流動負債	89,150	1	56,803	1	40,459	-
1990 其他非流動資產(附註六(十))	365,678	3	770,807	5	1,177,197	8		2,010,963	14	2,047,436	14	2,658,090	17
	7,701,545	54	7,740,433	53	7,616,371	51	負債總計	6,571,697	46	6,890,644	48	7,565,954	50
資產總計	\$ 14,216,385	100	14,368,107	100	15,146,165	100	歸屬母公司業主之權益：(附註六(十九))						
							3110 普通股股本	2,494,539	18	2,494,539	17	2,427,129	16
							3200 資本公積	1,394,973	10	1,394,743	10	1,121,495	7
							3300 保留盈餘	2,693,278	18	2,593,089	18	2,931,025	20
							3400 其他權益	(466,989)	(3)	(445,618)	(3)	(236,114)	(2)
							3500 庫藏股票	(430,042)	(3)	(430,042)	(3)	(430,042)	(3)
							歸屬母公司業主之權益合計	5,685,759	40	5,606,711	39	5,813,493	38
							36XX 非控制權益(附註六(五))	1,958,929	14	1,870,752	13	1,766,718	12
							權益總計	7,644,688	54	7,477,463	52	7,580,211	50
							負債及權益總計	\$ 14,216,385	100	14,368,107	100	15,146,165	100

董事長：王秀亭



經理人：王秀亭



會計主管：王永康



(請詳閱後附合併財務報告附註)

僅經核閱，未依一般公認審計準則查核
台灣半導體股份有限公司及子公司
合併綜合損益表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣千元

	109年1月至3月		108年1月至3月	
	金額	%	金額	%
4110 銷貨收入(附註六(廿一)及十四)	\$ 2,438,985	102	2,576,438	104
4190 減：銷貨退回及折讓	57,422	2	100,823	4
營業收入淨額	2,381,563	100	2,475,615	100
5000 營業成本(附註六(四))	1,695,523	71	1,658,651	67
營業毛利	686,040	29	816,964	33
6000 營業費用(附註六(十七))：				
6100 推銷費用	269,182	11	280,458	11
6200 管理費用	143,443	6	165,173	7
6300 研究發展費用	69,849	2	70,484	3
	482,474	19	516,115	21
營業淨利	203,566	10	300,849	12
營業外收入及支出(附註六(廿二))：				
7010 其他收入	47,249	2	16,016	1
7020 其他利益及損失	10,065	-	11,674	-
7050 財務成本	(17,488)	(1)	(17,965)	(1)
	39,826	1	9,725	-
稅前淨利	243,392	11	310,574	12
7950 減：所得稅費用(附註六(十八))	60,950	3	61,619	2
本期淨利	182,442	8	248,955	10
8300 其他綜合損益：				
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(14,600)	(1)	77,804	3
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	(1,910)	-	(2,113)	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(16,510)	(1)	75,691	3
8300 本期其他綜合損益	(16,510)	(1)	75,691	3
本期綜合損益總額	\$ 165,932	7	324,646	13
本期淨利歸屬於：				
母公司業主	\$ 100,189	4	143,722	6
非控制權益(附註六(五))	82,253	4	105,233	4
	\$ 182,442	8	248,955	10
綜合損益總額歸屬於：				
母公司業主	\$ 78,818	3	214,041	9
非控制權益(附註六(五))	87,114	4	110,605	4
	\$ 165,932	7	324,646	13
基本每股盈餘(元)(附註六(廿四))	\$ 0.42		0.63	
稀釋每股盈餘(元)(附註六(廿四))	\$ 0.41		0.60	

董事長：王秀亭



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：王秀亭



會計主管：王永康



僅經核閱，未依一般公認審計準則查核
台灣半導體股份有限公司及子公司
合併權益變動表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益						國外營運機構財務報表換算之兌換差額	庫藏股票	歸屬於母公司業主權益總計	非控制權益	權益總額
	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	合計					
民國一〇八年一月一日餘額	\$ 2,427,129	1,104,513	696,902	302,150	1,789,499	2,788,551	(306,433)	(391,565)	5,622,195	1,672,196	7,294,391
追溯適用新準則之調整數	-	-	-	-	(1,248)	(1,248)	-	-	(1,248)	(2,176)	(3,424)
期初重編後餘額	2,427,129	1,104,513	696,902	302,150	1,788,251	2,787,303	(306,433)	(391,565)	5,620,947	1,670,020	7,290,967
本期淨利	-	-	-	-	143,722	143,722	-	-	143,722	105,233	248,955
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	70,319	-	70,319	5,372	75,691
本期綜合損益總額	-	-	-	-	143,722	143,722	70,319	-	214,041	110,605	324,646
採用權益法認列之關聯企業變動數	-	16,982	-	-	-	-	-	-	16,982	-	16,982
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	(38,477)	(38,477)	-	(38,477)
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(13,907)	(13,907)
民國一〇八年三月三十一日餘額	\$ 2,427,129	1,121,495	696,902	302,150	1,931,973	2,931,025	(236,114)	(430,042)	5,813,493	1,766,718	7,580,211
民國一〇九年一月一日餘額	\$ 2,494,539	1,394,743	778,133	306,434	1,508,522	2,593,089	(445,618)	(430,042)	5,606,711	1,870,752	7,477,463
本期淨利	-	-	-	-	100,189	100,189	-	-	100,189	82,253	182,442
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(21,371)	-	(21,371)	4,861	(16,510)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	100,189	100,189	(21,371)	-	78,818	87,114	165,932
採用權益法認列之關聯企業變動數	-	230	-	-	-	-	-	-	230	-	230
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,063	1,063
民國一〇九年三月三十一日餘額	\$ 2,494,539	1,394,973	778,133	306,434	1,608,711	2,693,278	(466,989)	(430,042)	5,685,759	1,958,929	7,644,688

董事長：王秀亭



經理人：王秀亭



(請詳閱後附合併財務報告附註)

會計主管：王永康



僅經核閱，未依一般公認審計準則查核
台灣半導體股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣千元

	109年1月至3月	108年1月至3月
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 243,392	310,574
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	180,115	142,159
攤銷費用	31,616	26,052
預期信用減損損失	308	866
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	5,586	1,175
利息費用	17,331	17,478
利息收入	(3,987)	(4,590)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	129	(1,797)
處分投資利益	(61)	(2,159)
非金融資產減損損失(迴轉利益)	(46)	515
其他	230	16,982
收益費損項目合計	231,221	196,681
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產減少	2,342	330,368
應收票據減少	92	990
應收帳款減少	121,157	98,556
其他應收款(增加)減少	(16,578)	14,682
存貨(增加)減少	(40,682)	125,014
預付款項(增加)減少	(23,492)	38,904
其他金融資產增加	(61,165)	(93,760)
應付票據減少	(1,781)	(1,859)
應付帳款增加(減少)	5,275	(238,077)
其他應付款減少	(61,302)	(277,235)
其他流動負債增加(減少)	(23,543)	7,401
淨確定福利負債減少	(12)	(7)
其他非流動負債增加	32,885	124
調整項目合計	164,417	201,782
營運產生之現金流入	407,809	512,356
收取之利息	4,061	10,650
支付之利息	(13,480)	(9,275)
支付之所得稅	(12,480)	(25,996)
營業活動之淨現金流入	385,910	487,735
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(119,131)	(108,178)
處分不動產、廠房及設備	-	7,607
其他金融資產(增加)減少	(301)	1,649
取得無形資產	(38,403)	(4,880)
企業合併取得	-	(1,114,605)
其他非流動資產(增加)減少	12,252	(31,729)
預付設備款增加	(9,609)	(103,586)
投資活動之淨現金流出	(155,192)	(1,353,722)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(310,046)	108,446
償還可轉換公司債	-	(1,200,000)
舉借長期借款	133,650	1,960,000
償還長期借款	(120,000)	-
存入保證金增加(減少)	(929)	39
租賃本金償還	(37,101)	(40,442)
其他應付款增加	3,389	-
庫藏股票買回成本	-	(38,447)
非控制權益淨變動	1,063	(13,907)
籌資活動之淨現金流入(出)	(329,974)	775,689
匯率變動對現金及約當現金之影響	(8,903)	29,620
本期現金及約當現金減少數	(108,159)	(60,678)
期初現金及約當現金餘額	2,230,256	2,695,571
期末現金及約當現金餘額	\$ 2,122,097	2,634,893

董事長：王秀亭



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：王秀亭



會計主管：王永康



僅經核閱，未依一般公認審計準則查核

台灣半導體股份有限公司及子公司

合併財務報告附註

民國一〇九年及一〇八年第一季

(除另有註明者外，所有金額均以新台幣千元為單位)

一、公司沿革

台灣半導體股份有限公司(以下稱「本公司」)於民國六十八年一月依中華民國公司法設立，註冊地址為新北市新店區北新路3段205號11樓。本公司股票於民國八十九年二月在中華民國證券櫃檯買賣中心(以下稱「櫃買中心」)掛牌交易。

本公司為透過業務及組織重組，朝向專業分工，以提升企業經營效率及產業競爭力，將條碼印表機事業處以新設分割方式，分割予新設之鼎翰科技股份有限公司(以下稱「鼎翰科技」)；經董事會決議訂定分割基準日為民國九十六年八月一日。

本公司及子公司(以下併稱「合併公司」)主要營業項目為整流器及條碼印表機之製造及買賣業務。

二、通過財務報告之日期及程序

本合併財務報告已於民國一〇九年五月十二日經董事會通過發布。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

(一)已採用金融監督管理委員會認可之新發布及修訂後準則及解釋之影響

合併公司自民國一〇九年起全面採用經金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)認可並於民國一〇九年生效之國際財務報導準則編製合併財務報告。相關新發布、修正及修訂之準則及解釋彙列如下：

新發布／修正／修訂準則及解釋	國際會計準則理事會發布之生效日
國際財務報導準則第3號之修正「業務之定義」	2020年1月1日
國際財務報導準則第9號、國際會計準則第39號及國際財務報導準則第7號之修正「利率指標變革」	2020年1月1日
國際會計準則第1號及國際會計準則第8號之修正「重大之定義」	2020年1月1日

合併公司評估適用上述新認可之國際財務報導準則，將不致對合併財務報告造成重大變動。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(二)金管會尚未認可之新發布及修訂準則及解釋

下表彙列國際會計準則理事會（以下稱理事會）已發布及修訂但尚未經金管會認可之準則及解釋：

新發布／修正／修訂準則及解釋	理事會發布 之生效日
國際財務報導準則第10號及國際會計準則第28號之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」	尚待理事會決定
國際財務報導準則第17號「保險合約」	2021年1月1日
國際會計準則第1號之修正「將負債分類為流動或非流動」	2022年1月1日

合併公司現正持續評估上述準則及解釋對合併公司財務狀況與經營結果之影響，相關影響待評估完成時予以揭露。

四、重大會計政策之彙總說明

(一)遵循聲明

本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則(以下稱「編製準則」)及金管會認可並發布生效之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製。本合併財務報告未包括依照金管會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下稱「金管會認可之國際財務報導準則」)所編製之整份年度合併財務報告應揭露之全部必要資訊。

除下列所述外，本合併財務報告所採用之重大會計政策與民國一〇八年度合併財務報告相同，相關資訊請參閱民國一〇八年度合併財務報告。

(二)合併基礎

1.列入本合併財務報告之子公司包含：

投資公司名稱	子公司名稱	業務性質	所持股權百分比		
			109.3.31	108.12.31	108.3.31
本公司	Ever Energetic Int'l Ltd. (Ever Energetic)	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %
本公司	Ever Winner Int'l Co., Ltd. (Ever Winner)	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %
本公司	Skyrise Int'l Ltd. (Skyrise)	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %
本公司	Taiwan Semiconductor Europe GmbH (TSCE)	一般進出口業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %
本公司	Taiwan Semiconductor Japan Ltd. (TSCJ)	整流器之買賣業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %
本公司	Taiwan Semiconductor (H.K.) Co., Ltd. (TSCH)	對各種生產事業之投資及整流器之買賣業務	25.22 %	25.22 %	25.22 %
本公司	鼎翰科技	條碼印表機之製造及買賣業務	36.38 %	36.38 %	36.44 %
Ever Energetic	TSCH	對各種生產事業之投資及整流器之買賣業務	36.96 %	36.96 %	36.96 %
Ever Energetic	TSC America, Inc.(TSCA)	整流器之買賣業務	75.00 %	75.00 %	75.00 %

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

投資公司名稱	子公司名稱	業務性質	所持股權百分比		
			109.3.31	108.12.31	108.3.31
Ever Winner	TSCH	對各種生產事業之投資及整流器之買賣業務	37.82 %	37.82 %	37.82 %
Ever Winner	TSCA	整流器之買賣業務	25.00 %	25.00 %	25.00 %
Ever Winner	上海瀚科國際貿易有限公司(上海瀚科)	整流器之買賣業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %
TSCH	陽信長威電子有限公司(陽信長威)	整流器之製造及買賣業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %
TSCH	天津長威科技有限公司(天津長威)	晶片之製造及買賣業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %
鼎翰科技	TSC Auto ID Technology EMEA GmbH (TSCAE)	條碼印表機及其零件之買賣	100.00 %	100.00 %	100.00 %
鼎翰科技	TSC Auto ID (H.K.) Ltd. (TSC HK)	各種生產事業之投資及一般進出口業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %
鼎翰科技	TSC Auto Technology America Inc. (TSCAA)	條碼印表機及其零件之買賣	100.00 %	100.00 %	100.00 %
鼎翰科技	鼎貫科技股份有限公司(鼎貫科技)	條碼印表機及其零件之買賣	100.00 %	100.00 %	100.00 %
鼎翰科技及TSCAA	Printronic Auto ID Technology Inc. (PTNX US)	條碼印表機及其零件之買賣	100.00 %	100.00 %	100.00 %
鼎翰科技	Diversified Labeling Solutions, Inc. (DLS)	印表機耗材及各式標籤紙之客製化設計、整合及產銷	100.00 %	100.00 %	100.00 %
TSCAE	TSC Auto ID Technology ME, Ltd. FZE (TSCAD)	條碼印表機及其零件之買賣	100.00 %	100.00 %	100.00 %
TSCAE	TSC Auto ID Technology Spain, S.L. (TSCAS)	條碼印表機及其零件之買賣	100.00 %	100.00 %	100.00 %
TSC HK	天津國聚科技有限公司(天津國聚)	條碼印表機及其零件之產銷	100.00 %	100.00 %	100.00 %
TSC HK	深圳鼎貫科技有限公司(深圳鼎貫)	條碼印表機及其零件之買賣	100.00 %	100.00 %	100.00 %
DLS	Precision Press & Label, Inc. (PPL)	印表機各式標籤紙及其耗材之銷售	100.00 %	100.00 %	100.00 %

2. 未列入合併財務報告之子公司：無。

(三) 員工福利

期中期間之確定福利計畫退休金係採用前一年度報導期間結束日(以下稱報導日)依精算決定退休金成本率，以年初至當期期末為基礎計算，並針對該報導日後之重大市場波動，及重大縮減、清償或其他重大一次性事項加以調整。

(四) 所得稅

合併公司係依國際會計準則公報第34號「期中財務報導」第B12段規定衡量及揭露期中期間之所得稅費用。

所得稅費用係以期中報導期間之稅前淨利乘以管理階層對於全年度預計有效稅率之最佳估計衡量，並依預計全年度當期所得稅費用及遞延所得稅費用之比例分攤為當期所得稅費用及遞延所得稅費用。

期中期間法定所得稅率變動時，其對遞延所得稅之影響數係一次認列於該稅率變動之期中報導期間。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

所得稅費用係直接認列於權益項目或其他綜合損益項目者，係就相關資產及負債於財務報導目的之帳面金額與其課稅基礎之暫時性差異，以預期實現或清償時之適用稅率予以衡量。

五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

管理階層依編製準則及金管會認可之國際會計準則第34號「期中財務報導」編製本合併財務報告時，必須作出判斷、估計及假設，其將對會計政策之採用及資產、負債、收益及費損之報導金額有所影響。實際結果可能與估計存有差異。

編製合併財務報告時，管理階層於採用合併公司會計政策時所作之重大判斷以及估計不確定性之主要來源與民國一〇八年度合併財務報告一致。

六、重要會計項目之說明

除下列所述外，本合併財務報告重要會計項目之說明與民國一〇八年度合併財務報告尚無重大差異，相關資訊請參閱民國一〇八年度合併財務報告。

(一)現金及約當現金

	109.3.31	108.12.31	108.3.31
現金及零用金	\$ 648	522	618
支票及活期存款	1,550,547	1,678,027	2,150,846
定期存款	570,902	551,707	483,429
	\$ 2,122,097	2,230,256	2,634,893

合併公司金融資產及負債之利率風險及敏感度分析之揭露請詳附註六(廿六)。

(二)金融資產及負債

1.明細如下：

	109.3.31	108.12.31	108.3.31
流 動：			
強制透過損益按公允價值衡量			
之金融資產：			
受益憑證	\$ -	-	201,023
遠期外匯合約	1,510	2,969	2,816
換匯交易	-	1,770	6
	\$ 1,510	4,739	203,845
其他金融資產：			
結構性定期存款	\$ 319,465	258,300	183,200
非 流 動：			
其他金融資產：			
存出保證金	\$ 67,545	67,244	67,555

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	<u>109.3.31</u>	<u>108.12.31</u>	<u>108.3.31</u>
流 動：			
強制透過損益按公允價值衡量			
之金融負債：			
遠期外匯合約	\$ 3,752	361	421
換匯交易	<u>1,247</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>\$ 4,999</u>	<u>361</u>	<u>421</u>
透過損益按公允價值衡量之金			
融負債：			
可轉換公司債贖賣回權(附			
註六(十三))	\$ -	-	<u>1,258</u>

合併公司已於附註六(廿六)揭露與金融工具相關之信用、貨幣及利率暴險。

- 2.從事衍生金融工具係因以規避營業活動所暴露之匯率風險，合併公司因未適用避險會計列報為強制透過損益按公允價值衡量之金融資產及持有供交易之金融負債之衍生工具明細如下：

<u>109.3.31</u>						
		<u>合約金額</u>		<u>幣別</u>		<u>到期期間</u>
賣出/買入遠期外匯	USD	9,000 /CNY	63,051	美元兌人民幣		109.04~109.07
賣出/買入遠期外匯	EUR	800 /USD	897	歐元兌美元		109.04~109.06
賣出/買入遠期外匯	EUR	200 /NTD	6,742	歐元兌台幣		109.05.27
賣出/買入遠期外匯	EUR	1,000 /NTD	34,173	歐元兌台幣		109.06.01
換匯交易	USD	4,900 /NTD	146,980	美元兌台幣		109.04.10
<u>108.12.31</u>						
		<u>合約金額</u>		<u>幣別</u>		<u>到期期間</u>
賣出/買入遠期外匯	USD	7,000 /CNY	49,319	美元兌人民幣		109.01~109.03
賣出/買入遠期外匯	EUR	750 /USD	829	歐元兌美元		109.01.08
賣出/買入遠期外匯	EUR	200 /USD	225	歐元兌美元		109.02.21
賣出/買入遠期外匯	EUR	2,000 /NTD	68,182	歐元兌台幣		109.02.10
換匯交易	USD	4,900 /NTD	149,254	美元兌台幣		109.01.09
<u>108.3.31</u>						
		<u>合約金額</u>		<u>幣別</u>		<u>到期期間</u>
賣出/買入遠期外匯	USD	8,000 /CNY	54,001	美元兌人民幣		108.04~108.10
賣出/買入遠期外匯	EUR	400 /USD	464	歐元兌美元		108.04
賣出/買入遠期外匯	EUR	1,000 /NTD	35,245	歐元兌台幣		108.06
賣出/買入遠期外匯	EUR	2,000 /USD	2,281	歐元兌美元		108.05
賣出/買入遠期外匯	USD	6,000 /NTD	184,558	美元兌台幣		108.04~108.05
換匯交易	USD	11,000 /NTD	338,811	美元兌台幣		108.04

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(三)應收票據及應收帳款

	<u>109.3.31</u>	<u>108.12.31</u>	<u>108.3.31</u>
應收票據	\$ 97	189	378
應收帳款	2,036,597	2,158,106	2,357,864
減：備抵損失	<u>(33,392)</u>	<u>(33,436)</u>	<u>(32,606)</u>
	<u>\$ 2,003,302</u>	<u>2,124,859</u>	<u>2,325,636</u>

合併公司針對所有應收票據及應收帳款採用簡化作法估計預期信用損失，亦即使用存續期間預期信用損失衡量，為此衡量目的，該等應收票據及應收帳款係按代表客戶依據合約條款支付所有到期金額能力之共同信用風險特性予以分組，並已納入前瞻性之資訊。

合併公司整流器部門應收票據及應收帳款之預期信用損失分析如下：

	<u>109.3.31</u>		
	<u>應收款項 帳面金額</u>	<u>加權平均預期 信用損失率</u>	<u>備抵存續期間 預期信用損失</u>
未逾期	\$ 1,009,639	1%	11,639
逾期1~90天	47,549	2%	951
逾期91~180天	994	3%	30
逾期181~270天	312	5%	16
逾期271~365天	668	10%	67
逾期365天以上	<u>6,172</u>	100%	<u>6,172</u>
	<u>\$ 1,065,334</u>		<u>18,875</u>
	<u>108.12.31</u>		
	<u>應收款項 帳面金額</u>	<u>加權平均預期 信用損失率</u>	<u>備抵存續期間 預期信用損失</u>
未逾期	\$ 1,029,706	1%	12,796
逾期1~90天	65,078	2%	1,302
逾期91~180天	1,411	3%	42
逾期181~270天	1,529	5%	77
逾期271~365天	513	10%	51
逾期365天以上	<u>4,941</u>	100%	<u>4,941</u>
	<u>\$ 1,103,178</u>		<u>19,209</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	108.3.31		
	應收款項 帳面金額	加權平均預期 信用損失率	備抵存續期間 預期信用損失
未逾期	\$ 1,175,620	1%	12,809
逾期1~90天	96,416	2%	1,928
逾期91~180天	6,467	3%	194
逾期365天以上	<u>5,308</u>	100%	<u>5,308</u>
	<u>\$ 1,283,811</u>		<u>20,239</u>

合併公司條碼列印機部門應收票據及應收帳款之預期信用損失分析如下：

	109.3.31		
	應收款項 帳面金額	加權平均預期 信用損失率	備抵存續期間 預期信用損失
未逾期	\$ 679,460	1%	5,955
逾期1~90天	270,273	1%	2,703
逾期91~180天	10,046	3%	301
逾期181~270天	5,524	5%	276
逾期271~365天	861	10%	86
逾期365天以上	<u>5,196</u>	100%	<u>5,196</u>
	<u>\$ 971,360</u>		<u>14,517</u>

	108.12.31		
	應收款項 帳面金額	加權平均預期 信用損失率	備抵存續期間 預期信用損失
未逾期	\$ 781,701	1%	5,011
逾期1~90天	250,782	1%	2,508
逾期91~180天	12,888	3%	387
逾期181~270天	3,438	5%	172
逾期271~365天	177	10%	18
逾期365天以上	<u>6,131</u>	100%	<u>6,131</u>
	<u>\$ 1,055,117</u>		<u>14,227</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	108.3.31		
	應收款項 帳面金額	加權平均預期 信用損失率	備抵存續期間 預期信用損失
未逾期	\$ 767,438	1%	6,327
逾期1~90天	278,349	1%	2,783
逾期91~180天	25,420	3%	763
逾期181~270天	554	5%	28
逾期271~365天	227	10%	23
逾期365天以上	<u>2,443</u>	100%	<u>2,443</u>
	<u>\$ 1,074,431</u>		<u>12,367</u>

合併公司應收票據及應收帳款之備抵損失變動表如下：

	<u>109年1月至3月</u>	<u>108年1月至3月</u>
期初餘額	\$ 33,436	26,748
本期認列	308	866
企業合併取得(附註六(廿五))	-	4,740
外幣換算損益	<u>(352)</u>	<u>252</u>
期末餘額	<u>\$ 33,392</u>	<u>32,606</u>

合併公司應收票據及應收帳款均未貼現或作為擔保品。

(四)存 貨

	<u>109.3.31</u>	<u>108.12.31</u>	<u>108.3.31</u>
製成品	\$ 902,271	953,411	1,137,512
減：備抵損失	<u>(71,513)</u>	<u>(71,650)</u>	<u>(62,191)</u>
	<u>830,758</u>	<u>881,761</u>	<u>1,075,321</u>
半成品及在製品	419,573	341,237	348,539
減：備抵損失	<u>(36,207)</u>	<u>(31,564)</u>	<u>(36,894)</u>
	<u>383,366</u>	<u>309,673</u>	<u>311,645</u>
原物料	570,983	535,041	422,969
減：備抵損失	<u>(27,386)</u>	<u>(20,552)</u>	<u>(11,889)</u>
	<u>543,597</u>	<u>514,489</u>	<u>411,080</u>
在途存貨	<u>44,098</u>	<u>55,214</u>	<u>38,039</u>
	<u>\$ 1,801,819</u>	<u>1,761,137</u>	<u>1,836,085</u>

合併公司民國一〇九年及一〇八年一月一日至三月三十一日認列為銷貨成本及費用之存貨成本分別為1,683,910千元及1,634,398千元。民國一〇九年及一〇八年一月一日至三月三十一日因存貨自成本沖減至淨變現價值而認列之營業成本分別為11,613千元及24,253千元。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

截至民國一〇九年三月三十一日、一〇八年十二月三十一日及三月三十一日止，合併公司之存貨均未有提供作質押擔保之情形。

(五)具重大非控制權益之子公司

子公司之非控制權益對合併公司具重大性者如下：

子公司名稱	公司註冊 之國家	非控制權益之所有權 權益及表決權之比例		
		109.3.31	108.12.31	108.3.31
鼎翰科技	台灣	63.62 %	63.62 %	63.56 %

上述子公司之彙總性財務資訊如下，該等財務資訊係依據金管會認可之國際財務報導準則所編製，該等財務資訊係合併公司間之交易尚未銷除前之金額：

彙總性財務資訊：

	109.3.31	108.12.31	108.3.31
流動資產	\$ 2,819,009	2,884,002	3,221,156
非流動資產	3,617,474	3,905,149	3,991,924
流動負債	(1,906,507)	(2,083,708)	(1,920,177)
非流動負債	(1,491,565)	(1,540,409)	(2,260,149)
淨資產	\$ <u>3,038,411</u>	<u>3,165,034</u>	<u>3,032,754</u>
非控制權益期末帳面金額	\$ <u>1,958,929</u>	<u>1,870,752</u>	<u>1,766,718</u>
		109年1月至3月	108年1月至3月
營業收入		\$ <u>1,288,833</u>	<u>1,290,942</u>
本期淨利		\$ 129,288	165,564
其他綜合損益		(257,204)	67,051
綜合損益總額		\$ <u>(127,916)</u>	<u>232,615</u>
歸屬於非控制權益之本期淨利		\$ <u>82,253</u>	<u>105,233</u>
歸屬於非控制權益之綜合損益總額		\$ <u>87,114</u>	<u>110,605</u>
營業活動現金流量	\$ 205,525	151,888	
投資活動現金流量	(23,286)	(1,132,673)	
籌資活動現金流量	(278,363)	917,450	
匯率變動對現金及約當現金之影響	(1,155)	(1,862)	
現金及約當現金淨減少數	\$ <u>(97,279)</u>	<u>(65,197)</u>	

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(六)不動產、廠房及設備

合併公司不動產、廠房及設備之成本、折舊及減損損失變動明細如下：

	土 地	房 屋 及 建 築	機 器 及 其 他 設 備	總 計
成本或認定成本：				
民國109年1月1日餘額	\$ 861,426	1,351,081	5,823,761	8,036,268
增 添	-	94,821	24,310	119,131
處 分	-	-	(3)	(3)
報 廢	-	-	(1,531)	(1,531)
其 他	-	-	414,051	414,051
匯率變動之影響	-	(5,115)	(30,431)	(35,546)
民國109年3月31日餘額	<u>\$ 861,426</u>	<u>1,440,787</u>	<u>6,230,157</u>	<u>8,532,370</u>
民國108年1月1日餘額	\$ 861,426	1,351,901	4,485,091	6,698,418
增 添	-	5,023	103,155	108,178
處 分	-	-	(9,380)	(9,380)
報 廢	-	-	(4,387)	(4,387)
其 他	-	-	14,609	14,609
透過企業合併取得(附註六(廿五))	-	-	338,019	338,019
匯率變動之影響	-	11,059	69,388	80,447
民國108年3月31日餘額	<u>\$ 861,426</u>	<u>1,367,983</u>	<u>4,996,495</u>	<u>7,225,904</u>
累計折舊：				
民國109年1月1日餘額	\$ -	425,827	3,278,852	3,704,679
本年度折舊	-	9,676	143,581	153,257
減損迴轉利益	-	-	(46)	(46)
處 分	-	-	(3)	(3)
報 廢	-	-	(1,402)	(1,402)
匯率變動之影響	-	(1,441)	(21,538)	(22,979)
民國109年3月31日餘額	<u>\$ -</u>	<u>434,062</u>	<u>3,399,444</u>	<u>3,833,506</u>
民國108年1月1日餘額	\$ -	394,341	2,925,650	3,319,991
本期折舊	-	8,978	102,276	111,254
減損損失	-	-	515	515
處 分	-	-	(2,220)	(2,220)
報 廢	-	-	(3,940)	(3,940)
匯率變動之影響	-	2,850	40,212	43,062
民國108年3月31日餘額	<u>\$ -</u>	<u>406,169</u>	<u>3,062,493</u>	<u>3,468,662</u>
帳面金額：				
民國109年1月1日	<u>\$ 861,426</u>	<u>925,254</u>	<u>2,544,909</u>	<u>4,331,589</u>
民國109年3月31日	<u>\$ 861,426</u>	<u>1,006,725</u>	<u>2,830,713</u>	<u>4,698,864</u>
民國108年1月1日	<u>\$ 861,426</u>	<u>957,560</u>	<u>1,559,441</u>	<u>3,378,427</u>
民國108年3月31日	<u>\$ 861,426</u>	<u>961,814</u>	<u>1,934,002</u>	<u>3,757,242</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

截至民國一〇九年三月三十一日、一〇八年十二月三十一日及三月三十一日止均未有提供作質押之情形。

(七)使用權資產

合併公司承租土地使用權、房屋及建築及運輸設備等之成本及折舊，其變動明細如下：

	土地使用權	房屋及建築	運輸設備	總計
使用權資產成本：				
民國109年1月1日餘額	\$ 17,585	491,779	10,563	519,927
增 添	-	1,690	750	2,440
匯率變動之影響	(204)	1,866	(33)	1,629
民國109年3月31日餘額	<u>\$ 17,381</u>	<u>495,335</u>	<u>11,280</u>	<u>523,996</u>
民國108年1月1日餘額	\$ 10,169	189,126	3,855	203,150
增 添	15,045	258,274	-	273,319
匯率變動之影響	246	2,566	(189)	2,623
民國108年3月31日餘額	<u>\$ 25,460</u>	<u>449,966</u>	<u>3,666</u>	<u>479,092</u>
使用權資產之折舊：				
民國109年1月1日餘額	\$ 8,148	94,417	3,919	106,484
提列折舊	88	25,833	937	26,858
匯率變動之影響	(96)	133	-	37
民國109年3月31日餘額	<u>\$ 8,140</u>	<u>120,383</u>	<u>4,856</u>	<u>133,379</u>
民國108年1月1日餘額	\$ -	-	-	-
提列折舊	8,359	21,765	781	30,905
匯率變動之影響	30	-	-	30
民國108年3月31日餘額	<u>\$ 8,389</u>	<u>21,765</u>	<u>781</u>	<u>30,935</u>
帳面金額：				
民國109年1月1日	<u>\$ 9,437</u>	<u>397,362</u>	<u>6,644</u>	<u>413,443</u>
民國109年3月31日	<u>\$ 9,241</u>	<u>374,952</u>	<u>6,424</u>	<u>390,617</u>
民國108年1月1日	<u>\$ 10,169</u>	<u>189,126</u>	<u>3,855</u>	<u>203,150</u>
民國108年3月31日	<u>\$ 17,071</u>	<u>428,201</u>	<u>2,885</u>	<u>448,157</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(八)無形資產

合併公司無形資產之成本及攤銷明細如下：

成 本：	專門技術	顧客關係	專利權	電腦軟體	商標權	合 計
民國109年1月1日餘額	\$ 150,309	442,715	50,607	201,913	13,356	858,900
單獨取得	-	-	-	38,403	-	38,403
匯率變動之影響	<u>1,128</u>	<u>3,617</u>	<u>-</u>	<u>(85)</u>	<u>108</u>	<u>4,768</u>
民國109年3月31日餘額	<u>\$ 151,437</u>	<u>446,332</u>	<u>50,607</u>	<u>240,231</u>	<u>13,464</u>	<u>902,071</u>
民國108年1月1日餘額	\$ 153,690	298,028	50,607	132,827	13,680	648,832
單獨取得	-	-	-	4,880	-	4,880
企業合併取得(附註六(廿五))	-	155,642	-	-	-	155,642
匯率變動之影響	<u>483</u>	<u>1,449</u>	<u>-</u>	<u>201</u>	<u>47</u>	<u>2,180</u>
民國108年3月31日餘額	<u>\$ 154,173</u>	<u>455,119</u>	<u>50,607</u>	<u>137,908</u>	<u>13,727</u>	<u>811,534</u>
累計攤銷：						
民國109年1月1日餘額	\$ 59,181	136,316	25,303	72,346	10,051	303,197
本期攤銷	4,071	12,518	1,582	11,782	1,663	31,616
匯率變動之影響	<u>467</u>	<u>1,188</u>	<u>-</u>	<u>(54)</u>	<u>84</u>	<u>1,685</u>
民國109年3月31日餘額	<u>\$ 63,719</u>	<u>150,022</u>	<u>26,885</u>	<u>84,074</u>	<u>11,798</u>	<u>336,498</u>
民國108年1月1日餘額	\$ 43,896	89,335	18,977	42,214	3,521	197,943
本期攤銷	4,159	11,952	1,582	6,664	1,695	26,052
匯率變動之影響	<u>146</u>	<u>327</u>	<u>-</u>	<u>80</u>	<u>16</u>	<u>569</u>
民國108年3月31日餘額	<u>\$ 48,201</u>	<u>101,614</u>	<u>20,559</u>	<u>48,958</u>	<u>5,232</u>	<u>224,564</u>
帳面金額：						
民國109年1月1日	<u>\$ 91,128</u>	<u>306,399</u>	<u>25,304</u>	<u>129,567</u>	<u>3,305</u>	<u>555,703</u>
民國109年3月31日	<u>\$ 87,718</u>	<u>296,310</u>	<u>23,722</u>	<u>156,157</u>	<u>1,666</u>	<u>565,573</u>
民國108年1月1日	<u>\$ 109,794</u>	<u>208,693</u>	<u>31,630</u>	<u>90,613</u>	<u>10,159</u>	<u>450,889</u>
民國108年3月31日	<u>\$ 105,972</u>	<u>353,505</u>	<u>30,048</u>	<u>88,950</u>	<u>8,495</u>	<u>586,970</u>

(九)商 譽

成 本	109.3.31	108.12.31	108.3.31
期初餘額	\$ 1,109,548	939,173	939,173
企業合併取得(附註六(廿五))	-	197,707	197,707
匯率變動之影響	<u>9,068</u>	<u>(27,332)</u>	<u>3,757</u>
期末餘額	<u>\$ 1,118,616</u>	<u>1,109,548</u>	<u>1,140,637</u>

鼎翰科技於民國一〇八年一月三十一日收購DLS，產生商譽美金6,433千元（折合新台幣197,707千元），主要係來自預期取得DLS之市場及競爭優勢，進而帶動美國地區營業收入成長所帶來之效益。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

鼎翰科技已依據收購價格分配報告調整自收購日起之原始會計處理及暫定金額，並重編比較期間資訊。

(十)其他非流動資產

	<u>109.3.31</u>	<u>108.12.31</u>	<u>108.3.31</u>
預付設備款	\$ 215,883	615,844	1,020,277
其他	149,795	154,963	156,920
	<u>\$ 365,678</u>	<u>770,807</u>	<u>1,177,197</u>

(十一)短期借款

	<u>109.3.31</u>	<u>108.12.31</u>	<u>108.3.31</u>
信用借款	\$ 1,255,739	1,567,377	410,000
進口貸款	196,462	194,870	888,800
	<u>\$ 1,452,201</u>	<u>1,762,247</u>	<u>1,298,800</u>
利率區間(%)	<u>0.46%~ 2.75%</u>	<u>0.52%~ 2.63%</u>	<u>0.45%~ 3.30%</u>

民國一〇九年及一〇八年一月一日至三月三十一日新增金額分別為1,452,201千元及1,298,800千元，償還之金額分別為1,762,247千元及1,190,354千元；短期借款之年利率區間分別為0.46%~2.75%及0.45%~3.30%。

有關合併公司利率、外幣及流動性風險之暴險資訊，請詳附註六(廿六)。

合併公司提供擔保品情形，請詳附註九。

(十二)長期借款

	<u>109.3.31</u>			
	<u>幣別</u>	<u>利率區間</u>	<u>到期年度</u>	<u>金額</u>
無擔保銀行借款	NTD	0.45%~0.70%	115.12.04	\$ 41,500
	NTD	0.45%~0.70%	113.12.25	58,000
	NTD	0.45%	114.03.28	13,650
	NTD	1.2%~1.25%	111.11.22	<u>915,000</u>
				1,028,150
減：一年內到期部分				<u>(50,000)</u>
合計				<u>\$ 978,150</u>

	<u>108.12.31</u>			
	<u>幣別</u>	<u>利率區間</u>	<u>到期年度</u>	<u>金額</u>
無擔保銀行借款	NTD	0.70%	115.12.04	\$ 41,500
	NTD	0.70%	113.12.25	58,000
	NTD	1.2%~1.25%	111.02.04	<u>915,000</u>
合計				<u>\$ 1,014,500</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	108.3.31			
	<u>幣 別</u>	<u>利率區間</u>	<u>到期年度</u>	<u>金 額</u>
無擔保銀行借款	NTD	1.2%~1.25%	111.01.29	\$ 1,960,000
減：一年內到期部分				<u>(245,000)</u>
合 計				<u>\$ 1,715,000</u>

鼎翰科技為償還於民國一〇七年十二月到期之可轉換公司債及收購DLS之營運資產，爰於民國一〇八年一月與銀行簽訂中長期借款合同，共計新台幣1,960,000千元，並徵提反向承諾不得將鼎翰科技新店辦公室及宜蘭利澤廠設定擔保予銀行外之第三人。其中與中國信託商業銀行額外約定，有關鼎翰科技年度及半年度合併財務報告之財務比率承諾如下：

1. 流動比率不得低於110%；負債／有形淨值比率不得高於220%；
2. 有形淨值應維持在新台幣12億元以上。
3. 償債準備比率不得低於1倍。

另台半公司於民國一〇九年及一〇八年一月一日至三月三十一日向金融機構借款分別為113,150千元及0千元，依合約規定還本寬限期為3~5年。

有關合併公司利率、外幣及流動性風險之暴險資訊，請詳附註六(廿六)。

合併公司提供擔保品情形，請詳附註九。

(十三)其他應付款

	<u>109.3.31</u>	<u>108.12.31</u>	<u>108.3.31</u>
應付薪資及獎金	\$ 260,578	340,282	302,590
應付設備款	115,008	86,636	72,078
其 他	<u>280,947</u>	<u>290,902</u>	<u>432,242</u>
	<u>\$ 656,533</u>	<u>717,820</u>	<u>806,910</u>

(十四)應付公司債

	<u>109.3.31</u>
	<u>本公司</u>
國內無擔保可轉換公司債總金額	\$ 1,000,000
應付公司債折價及發行成本	(12,423)
減：累積轉換金額	(96,800)
一年內到期部份	<u>(890,777)</u>
	<u>\$ -</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	<u>108.12.31</u>
	<u>本公司</u>
國內無擔保可轉換公司債	\$ 1,000,000
應付公司債折價及發行成本	(15,812)
減：累積轉換金額	(96,800)
一年內到期部份	<u>(887,388)</u>
	<u>\$ -</u>
	<u>108.3.31</u>
	<u>本公司</u>
國內無擔保可轉換公司債總金額	\$ 1,000,000
應付公司債折價及發行成本	(25,976)
減：累積轉換金額	(96,800)
一年內到期部份	<u>(877,224)</u>
	<u>\$ -</u>

1. 合併公司民國一〇九年及一〇八年一月一日至三月三十一日認列公司債折價攤銷利息費用均為3,389千元。
2. 本公司發行之第五次國內無擔保可轉換公司債說明如下：

本公司於民國一〇七年三月二日發行第五次無擔保可轉換公司債總額為新台幣1,000,000千元，發行期間3年，依票面金額之100.1%發行，票面利率為零。

依據轉換辦法，轉換價格係依據基準日(不含)前一、三及五個營業日，本公司普通股收盤價之簡單算術平均數擇一者為基準價格，再以基準價格乘以102%為計算依據。發行日之轉換價格為每股63元。遇有本公司已發行之普通股股份增加時，本公司應依規定調整本轉換公司債之轉換價格。即自民國一〇八年十二月十八日起調整轉換價格為每股57.2元。債權人於本轉換公司債發行之日後屆滿三個月之翌日起至到期日止，除依法暫停過戶期間外，得向本公司請求轉換為本公司普通股股票。本轉換公司債發行滿三個月之翌日起至發行期間屆滿前四十日止，若本公司普通股收盤價格連續三十個營業日超過當時轉換價格達百分之三十時，本公司得按債券面額以現金收回流通在外之本轉換公司債。本轉換公司債以發行滿二年為債權人提前賣回本轉換公司債之賣回基準日，要求本公司以債券面額之101.0025%(滿二年之實質年收益率為0.5%)將其所持有之本轉換公司債贖回，本公司受理賣回請求，應於賣回基準日後五個營業日內以現金贖回本轉換公司債。故依轉換辦法，自民國一〇八年三月二日起，債權人可行使賣回權，本公司基於保守原則，已將應付可轉換公司債全數轉列於流動負債，列於一年內到期之應付公司債項下，並非表示必須於一年內全部償還。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

本公司發行無擔保可轉換公司債，依規定於發行時將其認股權與負債分離，並依原始認列金額比例分攤發行成本至負債及權益組成要素，相關資訊如下：

轉換公司債發行總金額(扣除發行成本5,334千元)	\$	995,666
發行時公司債公允價值		(954,984)
發行時嵌入式非權益衍生商品(金融負債)		<u>(1,194)</u>
權益組成項目－認股權	\$	<u><u>39,488</u></u>

民國一〇九年及一〇八年三月三十一日嵌入式非權益衍生商品以評價方式重新評估其公允價值分別為負債0千元及1,258千元，分別列於透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動及非流動項下。民國一〇九年及一〇八年一月一日至三月三十一日因其公允價值變動而認列之金融資產/負債評價損益分別為0千元及1,797千元。

3. 鼎翰科技於民國一〇四年十二月三十一日發行票面利率為零之國內第一次無擔保轉換公司債，並於同日在櫃檯買賣中心掛牌買賣，本金金額共計1,200,000千元，每張票面金額100千元，依票面金額之100.2%發行，發行期間為3年，轉換期間為民國一〇五年二月一日至一〇七年十二月三十一日止。發行時之轉換價格為每股342.8元，此後轉換價格依反稀釋條款辦法所訂之公式調整。

該轉換公司債自發行滿一個月後翌日起至發行期間屆滿前四十日止，若鼎翰科技普通股股票在集中交易市場之收盤價格連續三十個營業日超過當時轉換價格達30%（含）時或本轉換債流通在外餘額低於原發行總額之10%時，得按債券面額以現金收回該轉換公司債。

鼎翰科技國內第一次無擔保轉換公司債最後轉換日為民國一〇七年十二月二十八日，業已於民國一〇八年一月十一日償還債券本金1,200,000千元。

(十五)租賃負債

合併公司租賃負債之帳面金額如下：

	<u>109.3.31</u>	<u>108.12.31</u>	<u>108.3.31</u>
流動	\$ <u>95,371</u>	<u>94,330</u>	<u>89,640</u>
非流動	\$ <u>285,923</u>	<u>319,567</u>	<u>333,137</u>

到期分析請詳附註六(廿六)金融工具。

租賃認列於損益之金額如下：

	<u>109年1月至3月</u>	<u>108年1月至3月</u>
租賃負債之利息費用	\$ <u>3,835</u>	<u>3,239</u>
短期租賃之費用	\$ <u>1,756</u>	<u>2,051</u>
低價值租賃資產之費用(不包含短期租賃之低價值租賃)	\$ <u>2,485</u>	<u>2,140</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

認列於現金流量表之金額如下：

	<u>109年1月至3月</u>	<u>108年1月至3月</u>
租賃之現金流出總額	\$ <u>37,101</u>	<u>40,442</u>

(十六)租賃

合併公司於民國一〇九年及一〇八年一月一日至三月三十一日間，無重大新增之營業租賃合約。

(十七)員工福利

1.確定福利計畫

因前一年度報導日後未發生重大市場波動、及重大縮減、清償或其他重大一次性事項，故合併公司採用民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日精算決定之退休金成本衡量及揭露期中期間之退休金成本。

合併公司列報為費用之明細如下：

	<u>109年1月至3月</u>	<u>108年1月至3月</u>
營業成本	\$ 170	225
推銷費用	46	64
管理費用	46	63
研究發展費用	<u>44</u>	<u>55</u>
	\$ <u>306</u>	<u>407</u>

2.確定提撥計畫

合併公司之確定提撥計畫係依勞工退休金條例之規定，依勞工每月工資6%之提繳率，提撥至勞工保險局之勞工退休金個人專戶。在此計畫下合併公司提撥固定金額至勞工保險局後，即無支付額外金額之法定或推定義務。

合併公司民國一〇九年及一〇八年一月一日至三月三十一日確定提撥退休金辦法下之退休金費用分別為12,467千元及12,259千元，已提撥至勞工保險局。

3.海外子公司則依當地法律適用確定提撥退休辦法，民國一〇九年及一〇八年一月一日至三月三十一日認列之退休金費用各為4,716千元及14,183千元。

(十八)所得稅

1.合併公司所得稅費用如下：

	<u>109年1月至3月</u>	<u>108年1月至3月</u>
當期所得稅費用		
當期產生	\$ 61,910	116,980
調整前期之當期所得稅	<u>205</u>	<u>-</u>
	<u>62,115</u>	<u>116,980</u>
遞延所得稅利益		
暫時性差異之發生	<u>(1,165)</u>	<u>(55,361)</u>
所得稅費用	\$ <u>60,950</u>	<u>61,619</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

2.合併公司認列於其他綜合損益之下的所得稅費用明細如下：

	<u>109年1月至3月</u>	<u>108年1月至3月</u>
後續可能重分類至損益之項目：		
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	\$ <u>1,910</u>	<u>2,113</u>

3.合併公司民國一〇九年及一〇八年一月一日至三月三十一日並無認列於權益之所得稅費用。

4.截至民國一〇九年三月三十一日止，本公司及鼎翰科技之營利事業所得稅結算申報，業經稅捐稽徵機關核定至民國一〇七年度。

5.本公司部份投資國外子公司之盈餘，因國外營運擴充資金所需，長期暫不擬匯回，故依國際會計準則公報第12號「所得稅」A39段規定，將此盈餘財稅差異視為永久性差異處理。

(十九)權益

1.股本

本公司民國一〇八年六月十四日經股東會決議於不超過10,000千股，每股面額新台幣10元額度範圍內授權董事會於股東會決議後一年內以私募方式辦理現金增資發行新股，並於民國一〇八年十月三十日董事會決議以每股44.5元之私募價格發行普通股6,741千股，每股面額10元，計299,975千元，以民國一〇八年十一月十八日為增資基準日，相關法定登記程序已辦理完竣。

本公司民國一〇九年三月三十一日、一〇八年十二月三十一日及三月三十一日額定股本皆為3,600,000千元(其中100,000千元係留供發行員工認股權憑證使用)，實收股本分別為2,494,539千元、2,494,539千元及2,427,129千元，每股面額均為10元。

2.資本公積

	<u>109.3.31</u>	<u>108.12.31</u>	<u>108.3.31</u>
股票發行溢價	\$ 639,859	639,859	407,294
可轉換公司債轉換溢價	490,769	490,769	490,769
庫藏股票交易	132,627	132,627	98,157
員工認股權發行溢價	24,378	24,378	24,378
轉換公司債應付利息補償金	17,020	17,020	17,020
員工認股權(附註六(二十))	1,543	1,543	1,543
可轉換公司債認股權(附註六(十四))	35,665	35,665	35,665
採權益法認列關聯企業變動數	53,112	52,882	46,669
	<u>\$ 1,394,973</u>	<u>1,394,743</u>	<u>1,121,495</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

依公司法規定，資本公積需優先填補虧損後，始得按股東原有股份之比例以已實現之資本公積發給新股或現金。前項所稱之已實現資本公積，包括超過票面金額發行股票所得之溢額及受領贈與之所得。依發行人募集與發行有價證券處理準則規定，每年撥充之合計金額，不得超過實收資本額百分之十。

3.法定盈餘公積

公司無虧損時，得經股東會決議，以法定盈餘公積發給新股或現金，以該項公積超過實收資本額百分之二十五之部分為限。

4.特別盈餘公積

本公司依證券主管機關規定於分派盈餘時，應就當年度發生之股東權益減項自可分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，不得分派。嗣後股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。

本公司於首次採用金管會認可之國際財務報導準則時，因選擇適用國際財務報導準則第1號「首次採用國際財務報導準則」豁免項目，而帳列股東權益項下之土地重估增值及累積轉換調整數依規定轉入保留盈餘之金額為302,150千元，依金管會民國101年4月6日金管證發字第1010012865號令規定提列相同數額之特別盈餘公積，並於使用、處分或重分類相關資產時，得就原提列特別盈餘公積之比例予以迴轉分派盈餘。截至民國一〇九年及一〇八年三月三十一日止，該項特別盈餘公積餘額皆為302,150千元。

又依上段所述函令規定，本公司於分派可分配盈餘時，就當年度發生之帳列其他股東權益減項淨額與上段所提列特別盈餘公積餘額之差額，自當期損益與前期未分配盈餘補提列特別盈餘公積；屬前期累積之其他股東權益減項金額，則自前期未分配盈餘補提列特別盈餘公積不得分派。嗣後其他股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。

5.盈餘分派及股利政策

依本公司章程規定，年度總決算如有盈餘，依法繳納稅捐，再提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列；其餘額再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，併同累計未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，股東股利之發放由董事會擬妥盈餘分配案，經股東會決議後辦理，其中現金股利不得低於股票股利總額之百分之十，但現金股利每股若低於0.2元則不予以發放改以股票股利發放。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

本公司分別於民國一〇九年三月二十六日經董事會擬議民國一〇八年度盈餘分配案及一〇八年六月十四日經股東常會決議民國一〇七年度盈餘分配案，有關分派予股東情形如下：

分派予普通股業主之股利：	108年度		107年度	
	配股率(元)	金額	配股率(元)	金額
現金	\$ 1.5000	371,781	3.0000	723,339

6. 庫藏股票

本公司依證券交易法第二十八條之二規定，為轉讓股份予員工，截至民國一〇九年及一〇八年三月三十一日買回庫藏股皆為1,600千股，買回成本為85,482千元。

本公司持有之庫藏股票依證券交易法規定不得質押，於未轉讓前，並不得享有股東權益。

另，截至民國一〇九年及一〇八年三月三十一日止，子公司鼎翰科技持有本公司普通股皆為11,490千股，買回成本皆為344,560千元，列於庫藏股票項下。

本公司於民國一〇八年度及一〇七年度，將子公司鼎翰科技持有本公司普通股所享之股利收入分別為34,470千元及34,257千元，自採用權益法認列子公司利益之份額轉列資本公積-庫藏股票交易項下。

7. 其他權益

	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額
民國109年1月1日	\$ (445,618)
換算國外營運機構淨資產所產生之兌換差額	(21,371)
民國109年3月31日餘額	\$ (466,989)
民國108年1月1日	\$ (306,433)
換算國外營運機構淨資產所產生之兌換差額	70,319
民國108年3月31日餘額	\$ (236,114)

(二十) 股份基礎給付

合併公司民國一〇九年及一〇八年一月一日至三月三十一日間股份基礎給付無重大變動，相關資訊請參閱民國一〇八年度合併財務報告。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(廿一)客戶合約之收入

1.收入之細分

	109年1月至3月		
	整流器 部 門	條碼列印機 部 門	合 計
主要地區市場：			
亞 洲	\$ 640,440	287,313	927,753
美 洲	149,139	698,906	848,045
歐 洲	285,196	302,582	587,778
其 他	17,987	-	17,987
	<u>\$ 1,092,762</u>	<u>1,288,801</u>	<u>2,381,563</u>
主要產品線：			
整流器	\$ 1,092,762	-	1,092,762
條碼列印機	-	1,288,801	1,288,801
	<u>\$ 1,092,762</u>	<u>1,288,801</u>	<u>2,381,563</u>

	108年1月至3月		
	整流器 部 門	條碼列印機 部 門	合 計
主要地區市場：			
亞 洲	\$ 673,917	410,074	1,083,991
美 洲	152,519	565,723	718,242
歐 洲	358,237	315,145	673,382
	<u>\$ 1,184,673</u>	<u>1,290,942</u>	<u>2,475,615</u>
主要產品線：			
整流器	\$ 1,184,673	-	1,184,673
條碼列印機	-	1,290,942	1,290,942
	<u>\$ 1,184,673</u>	<u>1,290,942</u>	<u>2,475,615</u>

2.合約餘額

	109.3.31	108.12.31	108.3.31
應收票據及應收帳款	\$ 2,036,694	2,158,295	2,358,242
減：備抵損失	(33,392)	(33,436)	(32,606)
合 計	<u>\$ 2,003,302</u>	<u>2,124,859</u>	<u>2,325,636</u>

應收票據及應收帳款及其減損之揭露請詳附註六(三)。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(廿二)營業外收益及費損

1.其他收入

	<u>109年1月至3月</u>	<u>108年1月至3月</u>
利息收入	\$ 3,987	4,590
出售選擇權權利金收入	152	382
其 他	<u>43,110</u>	<u>11,044</u>
	<u>\$ 47,249</u>	<u>16,016</u>

2.其他利益及損失

	<u>109年1月至3月</u>	<u>108年1月至3月</u>
處分不動產、廠房及設備利益(損失)	\$ (129)	1,797
處分投資利益	61	2,159
外幣兌換利益	20,823	11,536
透過損益按公允價值衡量之金融工具損失	(5,586)	(1,175)
不動產、廠房及設備減損迴轉利益(損失)	46	(515)
其 他	<u>(5,150)</u>	<u>(2,128)</u>
	<u>\$ 10,065</u>	<u>11,674</u>

3.財務成本

	<u>109年1月至3月</u>	<u>108年1月至3月</u>
利息費用	\$ (17,331)	(17,478)
其他財務費用	<u>(157)</u>	<u>(487)</u>
	<u>\$ (17,488)</u>	<u>(17,965)</u>

(廿三)員工及董事酬勞

依本公司章程規定，本公司年度如有獲利，應先提撥至少百分之四，但以不超過百分之十為員工酬勞，並提撥不超過百分之一為董事酬金。

本公司如有以前年度累積虧損，於當年度有獲利須提撥員工酬勞及董事酬勞金之前，應先彌補虧損，其餘額再依前項比例提撥；又員工酬勞以股票或現金發放時，發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工。

前項董事酬勞金僅得以現金為之。員工酬勞及董事酬勞金分派案，應由董事會決議，並報告股東會。

本公司民國一〇九年及一〇八年一月一日至三月三十一日員工酬勞估列金額分別為6,463千元及10,512千元，董事酬勞金估列金額分別為1,077千元及1,752千元，係以本公司各該段期間之稅前淨利扣除員工及董事酬勞前之金額乘上本公司章程訂定之員工酬勞及董事酬勞分派成數為估計基礎，並列報為該段期間之營業費用。若實際分派金額與估列數有差異時，則依會計估計變動處理，並將該差異列為發放年度之損益。本公司民國一〇八年度及一〇七年度員工酬勞估列金額分別為38,197千元及64,838千

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

元，董事酬勞金估列金額分別為6,366千元及10,806千元，係以本公司各該段期間之稅前淨利扣除員工及董事酬勞前之金額乘上本公司章程訂定之員工酬勞及董事酬勞分派成數為估計基礎，並列報為該段期間之營業費用。相關資訊可至公開資訊觀測站查詢。前述董事會決議分派之員工及董事酬勞金額與本公司民國一〇八年度及一〇七年度合併財務報告估列金額並無差異。

(廿四)每股盈餘

1.基本每股盈餘

	109年1月至3月	108年1月至3月
本期淨利	\$ <u>100,189</u>	<u>143,722</u>
加權平均流通在外股數(千股)	<u>236,364</u>	<u>229,623</u>
基本每股盈餘(元)	\$ <u>0.42</u>	<u>0.63</u>

2.稀釋每股盈餘

	109年1月至3月	108年1月至3月
本期淨利	\$ 100,189	143,722
轉換公司債利息費用之稅後影響數	2,711	2,711
計算稀釋每股盈餘之本期淨利	\$ <u>102,900</u>	<u>146,433</u>
加權平均流通在外股數(千股)	236,364	229,623
員工酬勞	1,422	1,279
轉換公司債轉換之影響	15,790	14,807
用以計算稀釋每股盈餘之當期流通在外普通股加權平均股數(千股)	<u>253,576</u>	<u>245,709</u>
稀釋每股盈餘(元)	\$ <u>0.41</u>	<u>0.60</u>

(廿五)企業合併

基於未來營運規劃及策略布局，鼎翰科技於民國一〇八年一月三十一日以美金36,648千元(折合新台幣1,126,369千元)收購DLS之主要業務及營運所需資產。

1.取得子公司業務

	主要營運活動	收購日	具表決權之 所有權權益/ 收購比例	移轉對價
DLS	印表機耗材及各式標 籤紙之客製化設 計、整合及產銷	108.1.31	100%	\$ <u>1,126,369</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

2.收購日取得之資產及承擔之負債公允價值

	<u>DLS</u>
流動資產	
現金及約當現金	\$ 11,764
應收帳款	242,400
存 貨	252,595
預付費用	10,751
非流動資產	
廠房及設備(含未完工程)	339,218
無形資產	155,642
遞延所得稅資產	6,169
存出保證金	1,633
流動負債	
應付帳款	(52,037)
其他應付款	(39,473)
	<u>\$ 928,662</u>

3.因收購產生之商譽

	<u>DLS</u>
移轉對價	\$ 1,126,369
減：所取得可辨認淨資產之公允價值	(928,662)
因收購產生之商譽	<u>\$ 197,707</u>

收購DLS產生之商譽，主要係來自控制溢價。此外，合併所支付之對價係包含預期產生之合併綜效、收入成長、未來市場發展。惟該等效益不符合可辨認無形資產之認列條件，故不單獨認列。

4.取得子公司之淨現金流出

	<u>DLS</u>
現金支付之對價	\$ 1,126,369
減：取得之現金餘額	(11,764)
	<u>\$ 1,114,605</u>

5.企業合併對經營成果之影響

自收購日民國一〇八年一月三十一日至三月三十一日起，來自被收購公司之經營成果如下：

	<u>DLS</u>
營業收入	<u>\$ 316,465</u>
本期稅前淨利	<u>\$ (22,708)</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

倘該等企業合併係發生於收購日所屬之會計年度開始日，民國一〇八年一月一日至三月三十一日鼎翰科技擬制營業收入為483,145千元，擬制淨損為(18,957)千元。該等金額無法反映若企業合併於收購當年度開始日完成時，鼎翰科技實際可產生之收入及營運結果，亦不應作為預測未來營運結果之用。

(廿六)金融工具

1.信用風險

(1)信用風險之暴險

金融資產之帳面金額代表最大信用暴險金額。

(2)信用風險集中情況

由於合併公司有廣大客戶群，並未顯著集中與單一客戶進行交易，並無銷貨收入佔營業收入金額10%。

(3)應收款項及債券之信用風險

應收票據及應收帳款之信用風險暴險資訊請詳附註六(三)。

2.流動性風險

下表為金融負債之合約到期日，包含估計利息但不包含淨額協議之影響。

	帳面金額	合 約 現金流量	1年	1-2年	2-5年	超過5年
109年3月31日						
非衍生金融負債						
短期借款	\$ 1,452,201	1,505,205	1,505,205	-	-	-
應付帳款	1,028,404	1,028,404	1,028,404	-	-	-
其他應付款	656,533	656,533	656,533	-	-	-
應付公司債	890,777	1,000,000	1,000,000	-	-	-
租賃負債	381,294	426,351	107,278	159,841	158,606	626
長期借款(含一年內到期)	1,028,150	1,059,857	1,039,459	11,358	8,722	318
衍生金融負債						
遠期外匯合約	3,752	3,752	3,752	-	-	-
換匯交易	1,247	1,247	1,247	-	-	-
	\$ 5,442,358	5,681,349	5,341,878	171,199	167,328	944
108年12月31日						
非衍生金融負債						
短期借款	\$ 1,762,247	1,775,449	1,775,449	-	-	-
應付票據及帳款	1,024,910	1,024,910	1,024,910	-	-	-
其他應付款	717,820	717,820	717,820	-	-	-
應付公司債	887,388	1,000,000	1,000,000	-	-	-
租賃負債	413,897	445,913	102,955	168,169	163,244	11,545
長期借款	1,014,500	1,042,281	1,026,604	12,071	3,017	589
衍生金融負債						
遠期外匯合約	361	361	361	-	-	-
	\$ 5,821,123	6,006,734	5,648,099	180,240	166,261	12,134

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	帳面金額	合 約	1年	1-2年	2-5年	超過5年
		現金流量				
108年3月31日						
非衍生金融負債						
短期借款	\$ 1,298,800	1,547,746	1,547,746	-	-	-
應付帳款	1,089,137	1,089,137	1,089,137	-	-	-
其他應付款	806,910	806,910	806,910	-	-	-
應付公司債	877,224	1,000,000	1,000,000	-	-	-
租賃負債	422,777	477,320	108,116	160,646	161,754	46,804
長期借款(含一年內到期)	1,960,000	2,117,549	823,494	705,852	588,203	-
衍生金融負債						
遠期外匯合約	421	421	421	-	-	-
可轉換公司債贖賣回權	1,258	1,258	1,258	-	-	-
	\$ 6,456,527	7,040,341	5,377,082	866,498	749,957	46,804

合併公司並不預期到期日分析之現金流量發生時點會顯著提早，或實際金額會有顯著不同。

3. 匯率風險

(1) 匯率風險之暴險

合併公司暴露於重大外幣匯率風險之金融資產及負債如下：

	109.3.31		108.12.31		108.3.31	
	匯率	台幣	匯率	台幣	匯率	台幣
金融資產						
貨幣性項目						
美 金	\$ 30.225	1,646,699	29.980	1,659,550	30.820	2,150,533
歐 元	33.24	545,789	33.59	574,148	34.61	603,931
日 圓	0.2788	148,807	0.2760	304,106	0.2783	309,295
港 幣	3.8980	487,207	3.849	490,516	3.926	431,827
人 民 幣	4.2550	1,338,568	4.3050	1,273,291	4.580	1,264,899
韓 元	0.0248	2,281	0.0260	1,981	0.0272	1,425
		\$ 4,169,351		4,303,592		4,761,910
衍生商品						
美 金	\$ 30.225	11	29.980	2,324	30.820	993
歐 元	33.24	1,499	33.95	645	34.61	1,823
		\$ 1,510		2,969		2,816

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	109.3.31		108.12.31		108.3.31	
	匯率	台幣	匯率	台幣	匯率	台幣
金融負債						
貨幣性項目						
美金	\$ 30.225	960,341	29.98	1,232,351	30.82	1,090,370
歐元	33.24	240,267	33.59	216,407	34.61	119,263
日圓	0.2788	63,430	0.2760	71,477	0.2783	41,032
港幣	3.8980	1,343	3.849	1,712	3.926	1,341
人民幣	4.2550	379,800	4.3050	439,773	4.580	349,011
韓元	0.0248	<u>2,287</u>	0.0260	<u>2,039</u>	0.0272	<u>1,427</u>
		<u>\$ 1,647,468</u>		<u>1,963,759</u>		<u>1,602,444</u>
衍生商品						
美金	\$ 30.225	4,999	29.98	356	30.82	421
歐元	33.24	<u>-</u>	33.59	<u>5</u>	34.61	<u>-</u>
		<u>\$ 4,999</u>		<u>361</u>		<u>421</u>

(2) 敏感性分析

合併公司貨幣性項目之匯率風險主要來自於以外幣計價之金融資產及金融負債，於換算時產生外幣兌換損益。於民國一〇九年及一〇八年三月三十一日當新台幣相對於上表所列外幣貶值或升值3%，而其他所有因素維持不變之情況下，民國一〇九年及一〇八年一月一日至三月三十一日之稅前淨利將分別增加或減少75,552千元及94,856千元；兩期分析係採用相同基礎。

(3) 貨幣性項目之兌換損益

由於合併公司功能性貨幣種類繁多，故採彙整方式揭露貨幣性項目之兌換損益資訊，民國一〇九年及一〇八年一月一日至三月三十一日外幣兌換利益（含已實現及未實現）分別為20,823千元及11,536千元。

4. 利率分析

合併公司之金融資產及金融負債利率暴險於本附註之流動性風險管理中說明。

下列敏感度分析係依衍生及非衍生工具於報導日之利率暴險而決定。對於浮動利率負債，其分析方式係假設報導日流通在外之負債金額於整年度皆流通在外。合併公司內部向主要管理階層報告利率時所使用之變動率為利率增加或減少1%，此亦代表管理階層對利率之合理可能變動範圍之評估。

若利率增加或減少1%，在所有其他變數維持不變之情況下，合併公司民國一〇九年及一〇八年一月一日至三月三十一日之稅前淨利將減少或增加24,804千元及32,588千元，主因係合併公司之變動利率銀行借款所致。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

5.其他價格風險：

如報導日權益證券價格變動(兩期分析係採用相同基礎，且假設其他變動因素不變)，對綜合損益項目之影響如下：

報導日證券價格	109年1月至3月		108年1月至3月	
	其他綜合損益稅後金額	稅後損益	其他綜合損益稅後金額	稅後損益
上漲1%	\$ -	-	-	1,608
下跌1%	\$ -	-	-	(1,608)

6.公允價值資訊

(1)金融工具之種類及公允價值

合併公司透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債係以重複性為基礎，按公允價值衡量。各種類金融資產及金融負債之帳面金額及公允價值(包括公允價值等級資訊，但非按公允價值衡量金融工具之帳面金額為公允價值之合理近似值者，及於活絡市場無報價且公允價值無法可靠衡量之權益工具投資，依規定無須揭露公允價值資訊)列示如下：

	109.3.31				
	帳面金額	公允價值			合計
		第一級	第二級	第三級	
透過損益按公允價值衡量之金融資產					
衍生金融資產	\$ 1,510	-	1,510	-	1,510
放款及應收款					
現金及約當現金	2,122,097	-	-	-	-
應收票據及應收帳款	2,003,302	-	-	-	-
其他應收款	52,883	-	-	-	-
其他金融資產	387,010	-	-	-	-
小計	4,565,292	-	-	-	-
合計	\$ 4,566,802	-	1,510	-	1,510
透過損益按公允價值衡量之金融負債					
衍生金融負債	\$ 4,999	-	4,999	-	4,999
按攤銷後成本衡量之金融負債					
銀行借款	2,480,351	-	-	-	-
應付帳款	1,028,404	-	-	-	-
其他應付款	656,533	-	-	-	-
應付公司債	890,777	-	-	-	-
租賃負債	381,294	-	-	-	-
存入保證金	1,319	-	-	-	-
小計	5,438,678	-	-	-	-
合計	\$ 5,443,677	-	4,999	-	4,999

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

		108.12.31			
		公允價值			
	帳面金額	第一級	第二級	第三級	合計
透過損益按公允價值衡量之金					
融資產					
衍生金融資產	\$ 4,739	-	4,739	-	4,739
放款及應收款					
現金及約當現金	2,230,256	-	-	-	-
應收票據及應收帳款	2,124,859	-	-	-	-
其他應收款	36,379	-	-	-	-
其他金融資產	325,544	-	-	-	-
小計	4,717,038	-	-	-	-
合計	\$ 4,721,777	-	4,739	-	4,739
透過損益按公允價值衡量之金					
融負債					
衍生金融負債	\$ 361	-	361	-	361
按攤銷後成本衡量之金融負債					
銀行借款	\$ 2,776,747	-	-	-	-
應付票據及應付帳款	1,024,910	-	-	-	-
其他應付款	717,820	-	-	-	-
應付公司債	887,388	-	-	-	-
租賃負債	413,897	-	-	-	-
存入保證金	2,248	-	-	-	-
小計	5,823,010	-	-	-	-
合計	\$ 5,823,371	-	361	-	361
		108.3.31			
		公允價值			
	帳面金額	第一級	第二級	第三級	合計
透過損益按公允價值衡量之金					
融資產					
受益憑證	\$ 201,023	201,023	-	-	201,023
衍生金融資產	2,822	-	2,822	-	2,822
小計	203,845	201,023	2,822	-	203,845
放款及應收款					
現金及約當現金	2,643,893	-	-	-	-
應收票據及應收帳款	2,325,636	-	-	-	-
其他應收款	68,385	-	-	-	-
其他金融資產	250,755	-	-	-	-
小計	5,288,669	-	-	-	-
合計	\$ 5,492,514	201,023	2,822	-	203,845

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	108.3.31				
	帳面金額	公允價值			合計
		第一級	第二級	第三級	
透過損益按公允價值衡量之金融負債					
衍生金融負債	\$ 421	-	421	-	421
可轉換公司債贖賣回權	1,258	-	1,258	-	1,258
小計	1,679	-	1,679	-	1,679
按攤銷後成本衡量之金融負債					
銀行借款	3,258,800	-	-	-	-
應付帳款	1,089,137	-	-	-	-
其他應付款	806,910	-	-	-	-
應付公司債	877,244	-	-	-	-
租賃負債	422,777	-	-	-	-
存入保證金	1,649	-	-	-	-
小計	6,456,517	-	-	-	-
合計	\$ 6,458,196	-	1,679	-	1,679

(2) 衡量公允價值所採用之評價技術及假設

A. 非衍生金融工具

金融工具如有活絡市場公開報價時，則以活絡市場之公開報價為公允價值。主要交易所及經判斷為熱門券之中央政府債券櫃台買賣中心公告之市價，皆屬上市（櫃）權益工具及有活絡市場公開報價之債務工具公允價值之基礎。

若能及時且經常自交易所、經紀商、承銷商、產業公會、訂價服務機構或主管機關取得金融工具之公開報價，且該價格代表實際且經常發生之公平市場交易者，則該金融工具有活絡市場公開報價。如上述條件並未達成，則該市場視為不活絡。一般而言，買賣價差甚大、買賣價差顯著增加或交易量甚少，皆為不活絡市場之指標。

除上述有活絡市場之金融工具外，其餘金融工具之公允價值係以評價技術或參考交易對手報價取得。透過評價技術所取得之公允價值可參照其他實質上條件及特性相似之金融工具之現時公允價值、現金流量折現法或以其他評價技術，包括以報導日可取得之市場資訊運用模型計算而得(例如櫃買中心參考殖利率曲線、Reuters商業本票利率平均報價)。

B. 衍生金融工具

係根據廣為市場使用者所接受之評價模型評價，例如折現法及選擇權定價模型。遠期外匯合約通常係根據目前之遠期匯率評價。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(3)公允價值等級間之移動

合併公司於民國一〇九年及一〇八年一月一日至三月三十一日公允價值衡量評價方式皆無任何層級間之移轉。

(廿七)財務風險管理

合併公司財務風險管理目標及政策與民國一〇八年度合併財務報告所揭露者無重大變動。

(廿八)資本管理

合併公司資本管理目標、政策及程序與民國一〇八年度合併財務報告所揭露者一致；另作為資本管理之項目之彙總量化資料與民國一〇八年度合併財務報告所揭露者亦無重大變動。相關資訊請參閱民國一〇八年度合併財務報告。

(廿九)非現金交易之投資及籌資活動

合併公司於民國一〇九年及一〇八年一月一日至三月三十一日並無非現金交易投資及籌資活動。

來自籌資活動之負債之調節如下表：

	<u>109.1.1</u>	現金流量	非現金之變動		<u>109.3.31</u>
			匯率變動	其他	
應付公司債	\$ 887,388	-	-	3,389	890,777
短期借款	1,762,247	(310,046)	-	-	1,452,201
長期借款	1,014,500	(36,350)	-	-	978,150
一年內到期之長期借款	-	50,000	-	-	50,000
租賃負債	413,897	(37,101)	(1,777)	6,275	381,294
存入保證金	<u>2,248</u>	<u>(929)</u>	-	-	<u>1,319</u>
來自籌資活動之負債總額	<u>\$ 4,080,280</u>	<u>(334,426)</u>	<u>(1,777)</u>	<u>9,664</u>	<u>3,753,741</u>

	<u>108.1.1</u>	現金流量	非現金之變動		<u>108.3.31</u>
			匯率變動	其他	
可轉換公司債	\$ 873,835	-	-	3,389	877,224
短期借款	1,190,354	108,446	-	-	1,298,800
長期借款	-	1,715,000	-	-	1,715,000
一年內到期之長期借款	-	245,000	-	-	245,000
租賃負債	196,405	(40,442)	6,347	260,467	422,777
存入保證金	1,610	39	-	-	1,649
其他應付款	<u>1,200,000</u>	<u>(1,200,000)</u>	-	-	-
來自籌資活動之負債總額	<u>\$ 3,462,204</u>	<u>828,043</u>	<u>6,347</u>	<u>263,856</u>	<u>4,560,450</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

七、關係人交易

(一) 母公司與最終控制者

本公司為合併公司之最終控制者。

(二) 主要管理人員報酬

主要管理人員報酬包括：

	<u>109年1月至3月</u>	<u>108年1月至3月</u>
短期員工福利	\$ 33,777	37,227
退職後福利	424	518
股份基礎給付	395	926
	<u>\$ 34,596</u>	<u>38,671</u>

有關股份基礎給付之說明請詳附註六(二十)。

八、質押之資產：無。

九、重大或有負債及未認列之合約承諾

合併公司向銀行融資而提供之保證票據明細如下：

	<u>109.3.31</u>	<u>108.12.31</u>	<u>108.3.31</u>
新台幣	\$ 2,590,000	2,590,000	2,270,000
美金	50,700	50,700	16,500

截至民國一〇九年及一〇八年三月三十一日止，合併公司無已開立信用狀尚未使用餘額。

十、重大之災害損失：無。

十一、重大之期後事項：無。

十二、其他

員工福利、折舊、折耗及攤銷費用功能別彙總如下：

功 能 別 性 質 別	109年1月至3月			108年1月至3月		
	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計
員工福利費用						
薪資費用	192,726	244,444	437,170	184,047	240,780	424,827
勞健保費用	17,730	20,434	38,164	15,134	19,595	34,729
退休金費用	6,679	10,810	17,489	15,411	11,438	26,849
董事酬金	-	6,566	6,566	-	8,368	8,368
其他員工福利費用	13,968	5,897	19,865	15,046	5,229	20,275
折舊費用	153,998	26,117	180,115	110,863	31,296	142,159
攤銷費用	54	31,562	31,616	14	26,038	26,052

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

十三、附註揭露事項

(一)重大交易事項相關資訊

民國一〇九年第一季合併公司依編製準則之規定，應再揭露之重大交易事項相關資訊如下：

1. 資金貸與他人：

單位：新台幣千元

編號	貸出資金之公司	貸與對象	往來科目	是否為關係人	本期最高金額(註4)	期末餘額	實際動支金額	利率區間	資金貸與性質(註1)	業務往來金額	有短期融通資金必要之原因	提列備抵損失金額	擔保品		對個別對象資金貸與限額(註2)	資金貸與限額(註3)
													名稱	價值		
1	鼎翰科技	TSCAA	其他應收款	是	242,000	241,800	145,080	3.1%	2	-	營運周轉	-	無	-	607,682	1,215,364
2	鼎翰科技	DLS	其他應收款	是	363,000	362,700	211,575	2.8%	2	-	營運周轉/購買資產	-	無	-	607,682	1,215,364

註1：短期融通資金之必要者。

註2：鼎翰科技資金貸與有短期融通資金性質之公司或行號，個別對象貸與金額以不超過鼎翰科技淨值20%為限。

註3：鼎翰科技資金貸與他人之總額以不超過鼎翰科技淨額40%為限。

註4：係按民國一〇九年三月三十一日美金匯率30.225換算台幣表達。

2. 為他人背書保證：

單位：新台幣千元

編號	背書保證者公司名稱	被背書保證對象		對單一企業背書保證限額(註2)	本期最高背書保證餘額(註4)	期末背書保證餘額	實際動支金額	以財產擔保之背書保證金額	累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率	背書保證最高限額(註3)	屬母公司對子公司背書保證	屬子公司對母公司背書保證	屬對大陸地區背書保證
		公司名稱	關係(註1)										
1	鼎翰科技	TSCAA	2	1,215,364	332,750	332,475	-	-	10.94%	1,823,047	N	N	N

註1：本公司之子公司。

註2：鼎翰科技對單一企業背書保證限額以不超過鼎翰科技淨值40%為限。

註3：鼎翰科技背書保證限額以不超過鼎翰科技淨值60%為限。

註4：係按民國一〇九年三月三十一日美金匯率30.225換算台幣表達。

3. 期末持有有價證券情形(不包含投資子公司、關聯企業及合資權益部分)：無。

4. 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。

5. 取得不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。

6. 處分不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。

7. 與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：

單位：新台幣千元

進(銷)貨之公司	交易對象名稱	關係	交易情形				交易條件與一般交易不同之情形及原因		應收(付)票據、帳款		備註
			進(銷)貨	金額	佔總進(銷)貨之比率	授信期間(註1)	單價	授信期間	餘額	佔總應收(付)票據、帳款之比率	
本公司	TSCH	子公司	銷貨	(148,680)	(6) %		-		214,725	11 %	
本公司	陽信長威	孫公司	進貨	440,546	26 %		-		(392,856)	(38) %	註2
鼎翰科技	TSCAE	子公司	銷貨	(273,074)	(11) %		-		386,372	19 %	
鼎翰科技	TSCAA	子公司	銷貨	(95,167)	(4) %		-		268,661	13 %	
鼎翰科技	天津國聚	子公司	進貨	86,372	5 %		-		(103,041)	(10) %	

註1：月結30-135天，必要時視其資金需求調整之。

註2：應付帳款係以淨額列示。

註3：相關交易業已沖銷，請參見附註十三(一)10。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

8.應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：

單位：新台幣千元

帳列應收款項之公司	交易對象名稱	關係	應收關係人款項餘額	週轉率	逾期應收關係人款項		應收關係人款項期後收回金額(註1)	提列備抵損失金額
					金額	處理方式		
本公司	TSCH	子公司	214,725	0.65 %	-		46,469	-
鼎翰科技	TSCAE	子公司	386,372	2.77 %	-		1,635	-
鼎翰科技	TSCAA	子公司	268,661	1.49 %	-		862	-
鼎翰科技	TSCAA	子公司	149,285	-	-		-	-
鼎翰科技	PTNX US	子公司	126,518	2.09 %	-		915	-
鼎翰科技	DLS	子公司	213,155	-	-		-	-
天津國聚	鼎翰科技	子公司	103,041	3.01 %	-		-	-

註1：截至查核報告日止。

註2：相關交易業已沖銷，請參見附註十三(一)10。

9.從事衍生工具交易：請詳附註六(二)。

10.母子公司間業務關係及重要交易往來情形：

編號	交易人名稱	交易往來對象	與交易人之關係	109年第一季交易往來情形			佔合併總營業收入或總資產之比率
				科目	金額	交易條件	
0	本公司	TSCE	1	推銷費用－佣金支出	18,575	按月支付	0.76 %
0	本公司	TSCE	1	應付費用	27,033		0.19 %
0	本公司	TSCJ	1	銷貨收入	67,108	註三	2.75 %
0	本公司	TSCJ	1	應收帳款	49,275		0.35 %
0	本公司	TSCH	1	銷貨收入	148,680	按月支付	6.10 %
0	本公司	TSCH	1	應收帳款	214,725		1.51 %
0	本公司	TSCH	1	其他應收款	265		-
0	本公司	TSCH	1	應付費用	92		-
0	本公司	鼎翰科技	1	銷貨收入	490	註三	0.02 %
0	本公司	鼎翰科技	1	應收帳款	544		-
0	本公司	鼎翰科技	1	進貨	23		- %
0	本公司	TSCA	1	銷貨收入	64,129	註三	2.63 %
0	本公司	TSCA	1	推銷費用－佣金支出	1,133		0.05 %
0	本公司	TSCA	1	應收帳款	82,543		0.58 %
0	本公司	TSCA	1	應付費用	1,213		-
0	本公司	上海瀚科	1	銷貨收入	18,227	按月支付	0.75 %
0	本公司	上海瀚科	1	應收帳款	29,027		0.20 %
0	本公司	上海瀚科	1	其他應收款	15		-
0	本公司	上海瀚科	1	進貨	20,666		0.85 %
0	本公司	上海瀚科	1	應付帳款	20,994		0.15 %
0	本公司	陽信長威	1	進貨	440,546	註四	18.06 %
0	本公司	陽信長威	1	應付帳款	392,856	註五	2.76 %
0	本公司	天津長威	1	進貨	38,451		1.58 %
0	本公司	天津長威	1	應付帳款	2,992		0.02 %
0	本公司	天津長威	1	其他應付款	35,038		0.25 %
0	本公司	天津長威	1	推銷費用－佣金支出	1,135		0.05 %
0	本公司	天津長威	1	應付費用	1,137		0.01 %
1	TSCE	本公司	2	銷貨收入	18,575	註三	0.76 %
1	TSCE	本公司	3	應收帳款	27,033		0.19 %
2	TSCH	TSCE	3	佣金支出	449		0.02 %
2	TSCH	TSCE	3	應付費用	240		-

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

編號	交易人名稱	交易往來對象	與交易人之關係	109年第一季交易往來情形			佔合併總營業收入或總資產之比率
				科目	金額	交易條件	
4	TSCA	TSCAA	3	佣金支出	1,496		0.06 %
4	TSCA	TSCAA	3	其他應收款	1,214		0.01 %
5	陽信長威	本公司	2	銷貨收入	440,546	註三	18.06 %
5	陽信長威	本公司	3	應收帳款	392,856		2.76 %
5	陽信長威	上海瀚科	3	銷貨收入	132,229	註三	5.42 %
5	陽信長威	上海瀚科	3	應收帳款	210,884		1.48 %
6	天津長威	本公司	3	銷貨收入	38,451	註三	1.58 %
6	天津長威	本公司	3	應收帳款	2,992		0.02 %
6	天津長威	本公司	3	其他應收款	35,038		0.25 %
6	天津長威	本公司	3	佣金收入	1,135		0.05 %
6	天津長威	本公司	3	其他應收款	1,137		0.01 %
6	天津長威	陽信長威	3	銷貨收入	32,151	註三	1.32 %
6	天津長威	陽信長威	3	應收帳款	34,118		0.24 %
6	天津長威	上海瀚科	3	其他應收款	451,030		3.17 %

註一、編號之填寫方式如下：

1.0代表母公司。

2.子公司依公司別由阿拉伯數字1開始依序編號。

註二、與交易人之關係種類標示如下：

1.母公司對子公司。

2.子公司對母公司。

3.子公司對子公司。

註三：銷售價格按一般市場價格為準。收款期間為月結90~180天。

註四：加工費係採成本加成，收款期間為月結90~180天。

註五：付款期限為進貨後月結180天。

(二)轉投資事業相關資訊：

民國一〇九年第一季合併公司之轉投資事業資訊如下：

單位：新台幣千元

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末持有			期中最高持股或出資情形	被投資公司本期損益	本期認列之投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額				
本公司	Ever Energetic	英屬維京群島	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	665,501	665,501	21,175	100.00 %	1,306,190	100.00 %	(1,774)	(1,774)	子公司(註2)
本公司	Ever Winner	英屬維京群島	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	465,127	465,127	16,010	100.00 %	1,335,996	100.00 %	9,726	9,726	子公司(註2)
本公司	Skyrise	英屬維京群島	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	2,845	2,845	50	100.00 %	1,956	100.00 %	-	-	子公司(註2)
本公司	TSCE	德國	一般進出口業務	10,972	10,972	-	100.00 %	28,789	100.00 %	(2,214)	(2,214)	子公司(註2)
本公司	TSCJ	日本	整流器之買賣業務	28,689	28,689	2	100.00 %	78,553	100.00 %	2,055	2,055	子公司(註2)
本公司	TSCH	香港	整流器之買賣業務	282,312	282,312	672	25.22 %	531,633	25.22 %	14,860	5,399	子公司(註2)
本公司	鼎翰科技	台灣	條碼印表機之製造及買賣	163,728	163,728	15,453	36.38 %	728,463	36.38 %	129,288	47,035	子公司(註1)
Ever Energetic	TSCA	美國	整流器之買賣業務	258,520	258,520	6,750	75.00 %	193,688	75.00 %	(9,688)	(7,266)	子公司(註2)
Ever Energetic	TSCH	香港	整流器之買賣業務	571,628	571,628	985	36.96 %	1,038,572	36.96 %	14,860	5,492	子公司(註2)
Ever Winner	TSCA	美國	整流器之買賣業務	83,813	83,813	2,250	25.00 %	64,563	25.00 %	(9,688)	(2,422)	子公司(註2)
Ever Winner	上海瀚科	中國大陸	整流器之買賣業務	4,461	4,461	-	100.00 %	133,746	100.00 %	6,528	6,528	子公司(註2)

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末持有			期中最高持股或出資情形	被投資公司本期損益	本期認列之投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額				
Ever Winner	TSCH	香港	整流器之買賣業務	792,254	792,254	1,008	37.82 %	1,062,738	37.82 %	14,860	5,620 (註2)	子公司
TSCH	陽信長威	中國大陸	整流器製造及買賣業務	966,119	966,119	-	100.00 %	1,875,899	100.00 %	7,678	7,678 (註1)	子公司
TSCH	天津長威	中國大陸	晶片之製造及買賣業務	787,044	787,044	-	100.00 %	610,842	100.00 %	(3,263)	(3,263) (註2)	子公司
鼎翰科技	TSCAE	德國	條碼印表機及其零件之銷售	2,943	2,943	-	100.00 %	(5,771)	100.00 %	4,251	4,251 (註1)	子公司
鼎翰科技	TSC HK	香港	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	51,738	51,738	11,711	100.00 %	395,802	100.00 %	4,190	4,190 (註1)	子公司
鼎翰科技	TSCAA	美國	條碼印表機及其零件之銷售	1,096,621	1,096,621	16,000	100.00 %	937,982	100.00 %	(14,367)	(14,367) (註1)	子公司
鼎翰科技	鼎貫科技	台灣	條碼印表機及其零件之銷售	5,000	5,000	500	100.00 %	4,540	100.00 %	492	492 (註1)	子公司
鼎翰科技	PTNX US	美國	條碼印表機及其零件之銷售	63,021	63,021	-	5.00 %	51,287	5.00 %	2,519	(250) (註1)	子公司
鼎翰科技	DLS	美國	印表機週邊耗材及各式標籤紙之客製化設計、整合及產銷	801,558	801,558	1	100.00 %	830,393	100.00 %	10,609	10,609 (註1)	子公司
TSCAE	TSCAD	阿拉伯聯合大公國	條碼印表機及其零件之銷售	8,234	8,234	-	100.00 %	(6,508)	100.00 %	(472)	(472) (註1)	子公司
TSCAE	TSCAS	西班牙	條碼印表機及其零件之銷售	124	124	-	100.00 %	1,867	100.00 %	101	101 (註1)	子公司
TSCAA	PTNX US	美國	條碼印表機及其零件之銷售	45,319 千美元	45,319 千美元	-	95.00 %	1,293,725	95.00 %	2,519	(4,757) (註1)	子公司
DLS	PPL	美國	印表機週邊耗材及標籤紙之銷售	115 千美元	115 千美元	850	100.00 %	(1,839)	100.00 %	765	765 (註1)	子公司
TSC HK	天津國聚	中國大陸	條碼印表機及其零件之產銷	45,338	44,970	-	100.00 %	405,755	100.00 %	2,892	2,892 (註1)	子公司
TSC HK	深圳鼎貫	中國大陸	條碼印表機及其零件之產銷	4,655	4,617	-	100.00 %	8,795	100.00 %	1,299	1,299 (註1)	子公司

註1：係依據被投資公司經會計師核閱之財務報告認列。

註2：係依據被投資公司未經會計師核閱之財務報告認列。

(三)大陸投資資訊：

1.轉投資大陸地區之事業相關資訊：

單位：新台幣千元

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式	本期末初自台灣匯出累積投資金額	本期匯出或收回投資金額		本期末自台灣匯出累積投資金額	被投資公司本期損益	本公司直接或間接投資之持股比例	期中最高持股或出資情形	本期認列投資損益	期末投資帳面價值	截至本期末已匯回投資收益
					匯出	收回							
上海瀚科	整流器之買賣業務	4,461	(三)	4,461	-	-	4,461	6,528	100.00 %	100.00 %	6,528	133,746	91,811
陽信長威	整流器之製造及買賣業務	1,667,160	(三)	628,196	-	-	628,196	7,678	100.00 %	100.00 %	7,678	1,875,899	250,864
天津長威	晶片之製造及買賣業務	387,173	(三)	387,173	-	-	387,173	(3,263)	100.00 %	100.00 %	(3,263)	610,842	360,942
天津國聚	條碼印表機及其零件之產銷	44,678	(三)	45,338	-	-	45,338	2,892	36.38 %	36.38 %	2,892	405,755	691,539
深圳鼎貫	條碼印表機及其零件之產銷	4,255	(三)	4,655	-	-	4,655	1,299	36.38 %	36.38 %	1,299	8,795	-

註1：透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

2. 赴大陸地區投資限額：

本期期末累計自台灣匯出 赴大陸地區投資金額	經濟部投審會核准 投資金額	依經濟部投審會規定 赴大陸地區投資限額
996,526	1,963,726	3,411,455

3. 與大陸被投資公司間之重大交易事項：

合併公司民國一〇九年一月一日至三月三十一日與大陸投資公司直接或間接之重大交易事項於編製合併報告時業已沖銷，請詳「重大交易事項相關資訊」之說明。

(四) 主要股東資訊：

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
富邦人壽保險股份有限公司		14,550,000	5.83 %

註：(1) 本表主要股東資訊係由集保公司以每季底最後一個營業日，計算股東持有公司已完成無實體登錄交付(含庫藏股)之普通股及特別股合計達百分之五以上資料。至於公司財務報告所記載股本與公司實際已完成無實體登錄交付股數，可能因編製計算基礎不同或有差異。

(2) 上開資料如屬股東將持股交付信託，係以受託人開立信託專戶之委託人個別分戶揭示。至於股東依據證券交易法令辦理持股超過百分之十之內部人股權申報，其持股包括本人持股加計其交付信託且對信託財產具有運用決定權股份等，有關內部人股權申報資料請參閱公開資訊觀測站。

十四、部門資訊

合併公司營運部門資訊及調節如下：

	109年1月至3月			
	整流器部門	條碼印表機 部門	調整及銷除	合計
收 入				
來自外部客戶收入	\$ 1,092,762	1,288,801	-	2,381,563
部門間收入	982,504	32	(982,536)	-
收入合計	\$ 2,075,266	1,288,833	(982,536)	2,381,563
應報導部門損益	\$ 70,149	173,243	-	243,392

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	108年1月至3月			
	整流器部門	條碼印表機 部 門	調整及銷除	合 計
收 入				
來自外部客戶收入	\$ 1,184,673	1,290,942	-	2,475,615
部門間收入	<u>1,061,000</u>	<u>-</u>	<u>(1,061,000)</u>	<u>-</u>
收入合計	<u>\$ 2,245,673</u>	<u>1,290,942</u>	<u>(1,061,000)</u>	<u>2,475,615</u>
應報導部門損益	<u>\$ 111,425</u>	<u>199,149</u>	<u>-</u>	<u>310,574</u>
應報導部門資產				
109年3月31日	<u>\$ 18,384,635</u>	<u>6,436,483</u>	<u>(10,604,733)</u>	<u>14,216,385</u>
108年12月31日	<u>\$ 18,480,700</u>	<u>6,789,151</u>	<u>(10,901,744)</u>	<u>14,368,107</u>
108年3月31日	<u>\$ 19,179,931</u>	<u>7,213,080</u>	<u>(11,246,846)</u>	<u>15,146,165</u>